

令和5年10月19日

関係各位

(一社) 日本実装技術振興協会
会長 嶋田 勇三

第223回定例講演会のお知らせ

拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

さて、日本実装技術振興協会の第223回定例講演会の内容が決まりましたのでお知らせいたします。

今回も会場とWEB会議システム（Zoom ウェビナー）を利用したハイブリッド開催となります。

ご多忙の中恐縮ではございますが、万障お繰り合わせの上、ご参加下さいますようお願い申し上げます。ホームページでも同定例講演会の情報を配信します。

敬具

記

1. 開催日時：令和5年11月16日（木）定例講演会 13：00～16：40

2. 開催方式：ハイブリッド方式

【川崎市産業振興会館第4会議室+WEB会議システム「Zoom ウェビナー」】

（Zoom参加を申し込みされた方には後日、招待メールをお送りします）

川崎市産業振興会館：神奈川県川崎市幸区堀川町66番地20

<https://kawasaki-sanshinkaikan.jp/>

3. プログラム：“通信の未来を担うテクノロジー”

(1) 13:00～13:50 プログラムテーマ①	『ADPF (Adk Direct Plated Film) の高速伝送用材料、その他への応用について』 株式会社旭電化研究所 代表取締役 溝口 昌範 氏 講演内容：同社は各種機能性フィルムに接着剤、ボンディングシートやプライマー処理などを介さず、直接湿式めっき法により導体形成を行う技術を開発した。各種機能性フィルムの特性を生かしたADPFの高速伝送用材料や、ビルドアップ材料などへ応用について紹介する。
(2) 13:50～14:40 プログラムテーマ②	『高精度チップオンウエハ実装技術の開発』 パナソニック ホールディングス株式会社 マニファクチャリングイノベーション本部 マニファクチャリングソリューションセンター 材料・デバイス技術部 総括担当 櫻井 大輔 氏 講演内容：社会のデジタルトランスフォーメーションが加速する中、データの高速度・大容量通信に対応すべく、先端半導体パッケージの2.5D、3D化が進む。同社は、2.5D、3Dチップレットに対応する高精度チップオンウエハ実装技術を開発した。本講演では、特にマイクロ接合プロセス、高精度実装プロセス、接合品質保証システムについて紹介する。
14:40～15:00	－ 休 憩 －
(3) 15:00～15：30 会社紹介	『桑と蚕が世界を救う！植物工場の進化』 株式会社モレラ 代表取締役社長 福島 知子 氏 講演内容：平成21年より植物工場を研究し、平成27年から世界で初めて【桑】の水耕栽培に成功し、新潟薬科大学、信州大学との共同研究において、露地桑と大きく成分が異なる事を発見し、商品化を行ってきた。本講演では、今までの経験を基に今世界が持つ課題【地球温暖化】に歯止めをかけるべく、砂漠の緑地化とそれに伴う新素材（バイオ繊維＝ダイオキシシズロ）の開発、その為の養蚕システムの構築をお話する。
(4) 15:30～16:30 プログラムテーマ③	『最新の電子機器の実装技術と実装技術の行方』 セミコンサルト 代表 上田 弘孝 氏 講演内容：この20年、スマートフォンや車載電子機器としてのADAS (Advanced driver-assistance systems：先進運転支援システム) 技術への注目度は高い。2010年頃までは、これらの分野での日系企業の存在は大きなものであった。それから13年を経過し、スマホもADASもコモディティ化が進み、日系メーカーの存在が薄れつつある。材料開発と実装開発と高信頼性・高品質にたけた日系メーカーも、標準化と大量生産による低価格化を実現する海外メーカー品の採用に苦戦する。 2001年当時の3G携帯電話で独自開発を進めた日系メーカーのCPU、チップセット、カメラ技術と海外大手スマホメーカーのそれらの技術を比較し、その進化の動向を概説する。また、ADASの代表であるカメラ、ミリ波レーダー、LiDARの実装技術にも触れる。

(5)16:30~16:40

『トークセッション』

講師の皆様と参加者の皆様とで、意見交換を行う時間を設けます。

4. 参加費

会 員：無料 企業正会員は1社3名まで（Web会議特例：3名を超える参加者については事務局にお問い合わせください）。また、同じ名前とメールアドレスで複数の方が入室した場合、システム上、同一人物が入室した人数分表示されます。1登録1名様のご利用でお申込みください。

会員外：22,000円/人（不課税）（お申し込み後、請求書をお送りします）

5. 参加申し込み

会 員：会員は別途メールでお送りしているご出欠連絡用紙（企業正会員には登録代表者（連絡担当者）にお送りしています）にご記入の上、E-mailにてお申し込みいただけますようお願いいたします。

※今回、会場とZoomウェビナーのハイブリッド方式での開催となります。お申し込みの際は、参加者それぞれ、どちらの方式での参加をご希望か記載してください。

※会場の都合で入場できる人数が限られます。また、会場参加者が多い場合、Zoom参加にご変更をお願いすることがございますのでご了承下さい。

会員外：参加形式はZoomウェビナーのみになります。ホームページのお問い合わせフォーム

(<https://www.j-jisso.org/p/contact.html>)より「お問い合わせ内容」の項目に第223回定例講演会参加希望の旨を記載してご連絡ください。申込者と参加者が異なる場合、参加者のお名前とE-mailアドレスもご記入ください。

申込締切日：**会 員** 令和5年11月7日（火）

会員外 令和5年11月1日（水）

※講演2日前までに、ご参加者各人に招待メールをお送りしますので、ご参加者全員の氏名・メールアドレスをご連絡ください。また、Zoomウェビナーに参加される際には、ご連絡いただきましたメールアドレス・参加者氏名でログインするようお願いいたします。セキュリティの関係上、名簿と合致しない場合、Zoom定例講演会から退場していただく場合がございます。参加者が変更する場合はご連絡ください。

※講演資料は、講演日1週間前に郵便で発送させていただきます（企業正会員は登録代表者（連絡担当者）にお送りします）。

ご不明な点がございましたら下記までお問い合わせ下さいますようお願い致します。

事務局：一般社団法人 日本実装技術振興協会事務局 担当/相良(サガラ)・太田
携帯：090-5403-1147 (相良)、090-5301-9467 (太田)
E-mail: j.jisso.org@gmail.com URL: <http://www.j-jisso.org/index.html>